

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
3. März 2005 (03.03.2005)

PCT

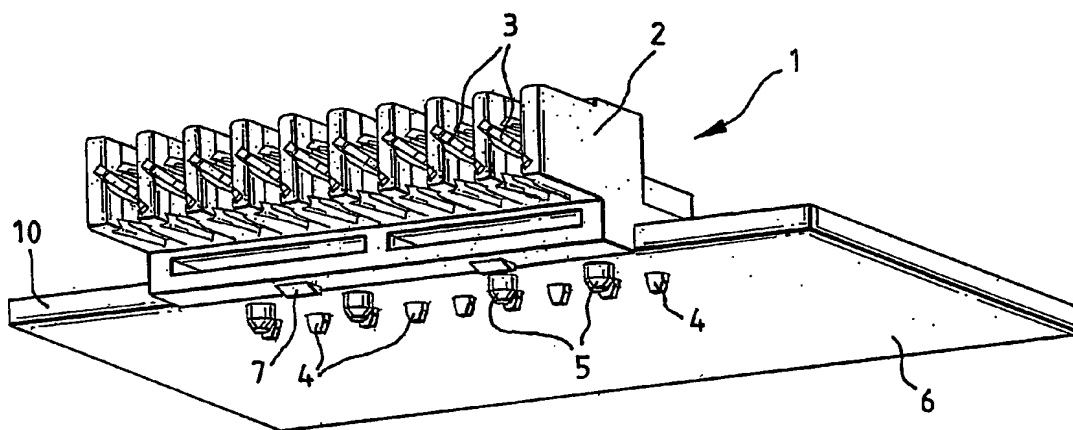
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/020376 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01R 12/04**, 4/24
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/006821
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
24. Juni 2004 (24.06.2004)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
103 33 913.2 25. Juli 2003 (25.07.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **KRONE GMBH** [DE/DE]; Beeskowdamm 3-11, 14167 Berlin (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **NEUMETZLER, Heiko** [DE/DE]; Breite Strasse 23, 12167 Berlin (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **KRONE GMBH**; Abteilung HRP, Beeskowdamm 3-11, 14167 Berlin (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONDUCTOR CONNECTING MODULE FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS

(54) Bezeichnung: ADERANSCHLUSSMODUL FÜR LEITERPLATTEN



(57) Abstract: The invention relates to a conductor connecting module (1) for printed circuit boards, comprising a housing (2) in which contact elements are disposed. Said contact elements have a first contact area that is configured as an insulation displacement contact (3), and a second contact area that is configured as a solderable contact pin (4). The contact pins (4) are disposed at a right angle to the insulation displacement contacts (3) so that the insulation displacement contacts (3), in the mounted state, lie in a plane parallel to the printed circuit board (6).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Aderanschlussmodul (1) für Leiterplatten, umfassend ein Gehäuse (2), in dem Kontaktelemente angeordnet sind wobei die Kontaktelemente einen ersten Kontaktbereich aufweisen, der als Schneid-Klemm-Kontakt (3) ausgebildet ist, und einen zweiten Kontaktbereich aufweisen, der als lötlarer Kontaktpin (4) ausgebildet ist, wobei die Kontaktpins (4) in einem rechten Winkel zu den Schneid-Klemm-Kontakten (3) angeordnet sind, so dass die Schneid-Klemm-Kontakte (3) im montierten Zustand in einer Ebene parallel zur Leiterplatte (6) liegen.

WO 2005/020376 A1



RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*